

2026年3月期 決算説明会

2026年5月21日

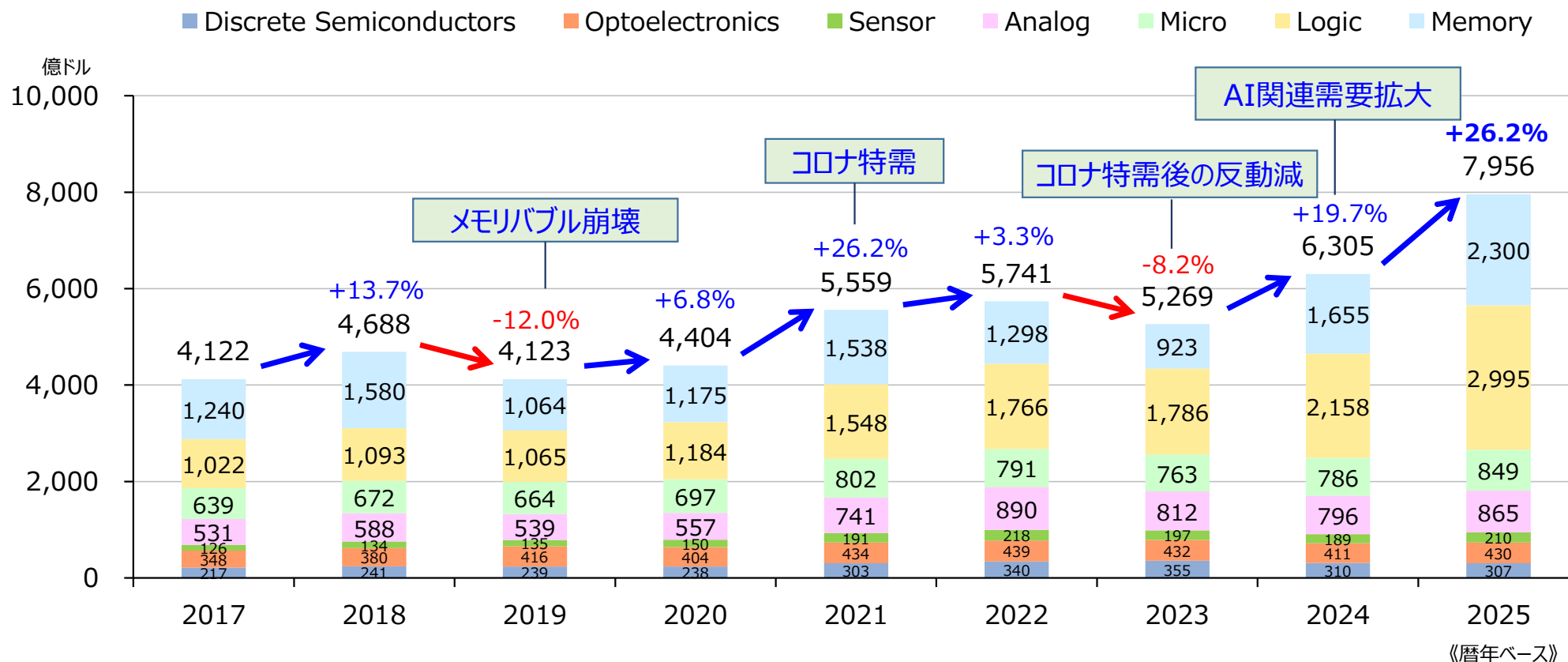
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（年次実績） 用途別

出所：WSTS（2026/3）

2025年：+26%・・・AI・データセンター向け需要やメモリ価格上昇を背景に、ロジックおよびメモリ製品が市場成長を牽引

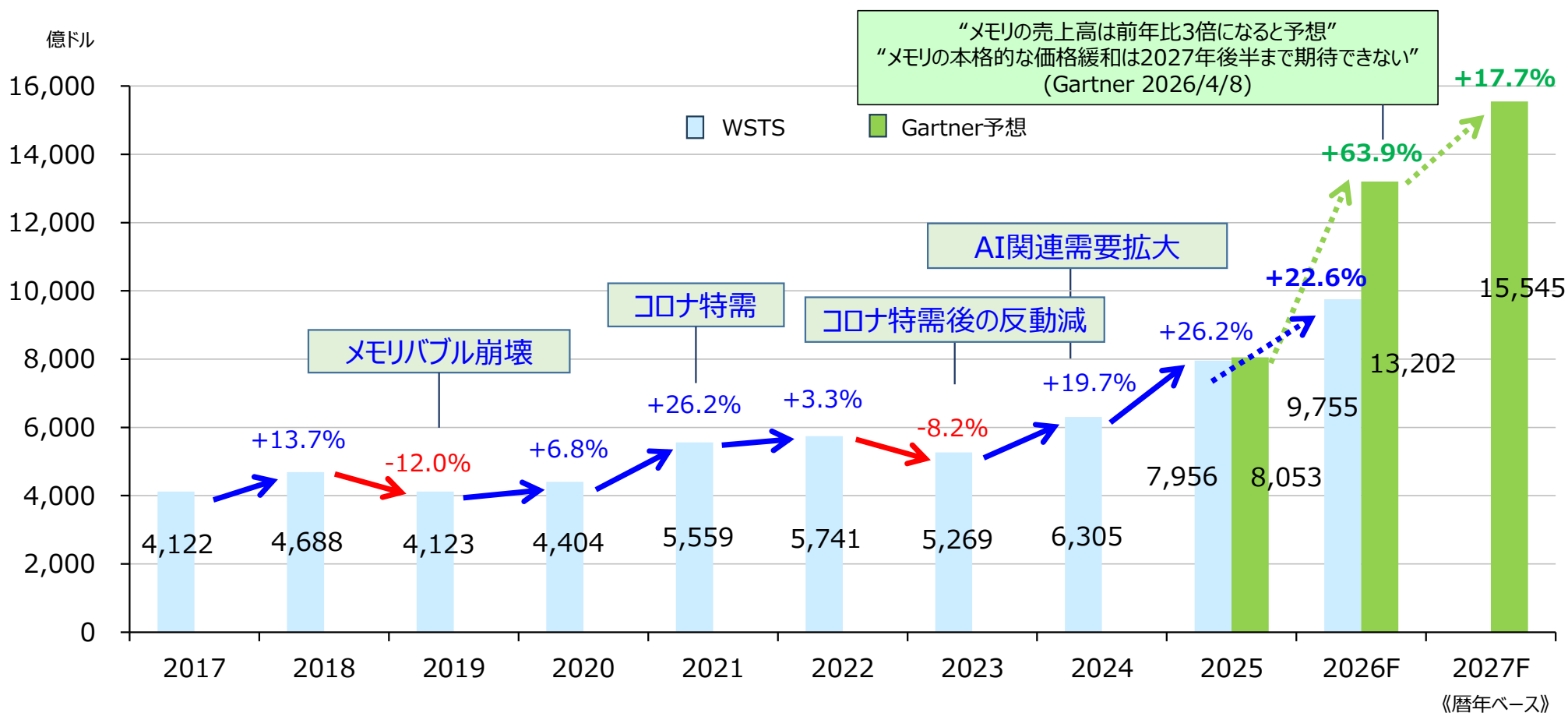


世界半導体市場動向（年次 WSTS・Gartner予測）

出所：WSTS …2025(2026/3), 2026F(2025/12) FUJIMI INCORPORATED
Gartner(2026/4)

2026年予想 (WSTS 2025年12月発表) : 9,755億米ドル
2026年予想 (Gartner 2026年 4月発表) : 1兆3,202億米ドル

2027年予想 (WSTS 2025年12月時点) : -
2027年予想 (Gartner 2026年 4月発表) : 1兆5,545億米ドル



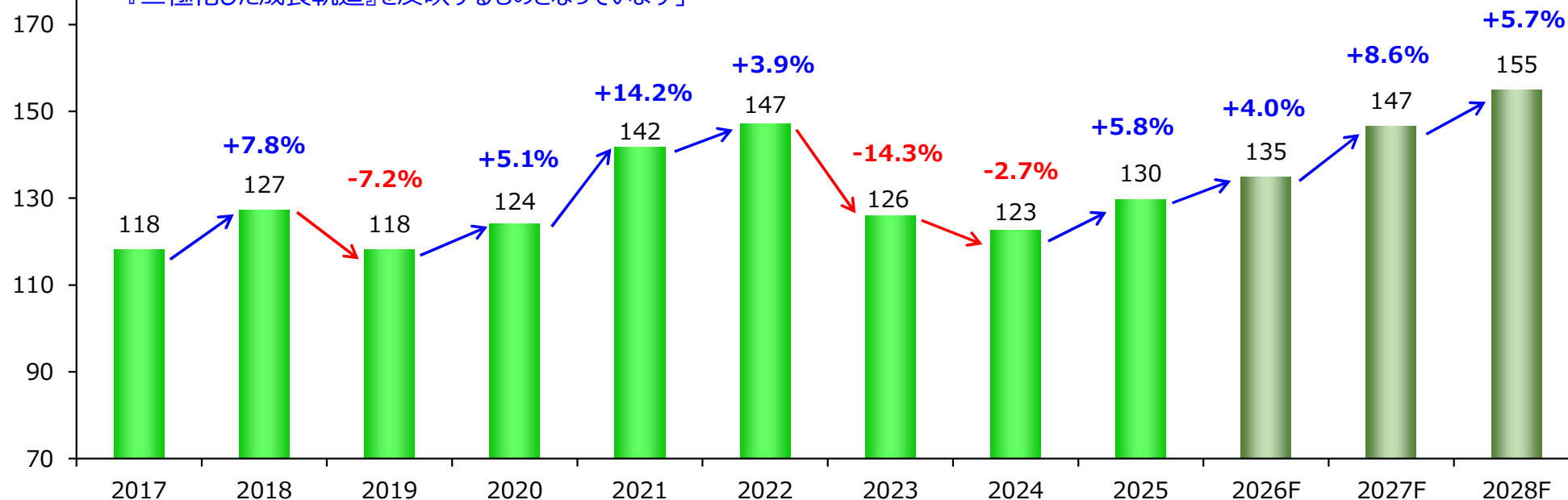
シリコンウェハ需要予測（出荷面積換算 全口径）

- ・2025年実績：+5.8%
- ・2026年予想（2025年10月28日）：+4.0%

（2026年2月10日付 SEMI Press Releaseより）

億平方インチ

「（ウェーハ）市場全体の見通しは、先端ノードにおける需要の持続と技術進展が続く一方で、成熟テクノロジー分野では慎重かつ段階的な需要回復が進むという『二極化した成長軌道』を反映するものとなっています」



決算概要

決算概要 (通期実績)

* 1 当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	25年3月期	26年3月期					
	通期実績	期初予想	修正予想 ('25/11)	通期実績	前期比	期初予想比	修正予想比
売上高	62,503	65,300	67,900	69,404	+11.0%	+6.3%	+2.2%
営業利益	11,780	12,100	13,000	13,826	+17.4%	+14.3%	+6.4%
率	18.8%	18.5%	19.1%	19.9%	-	-	-
経常利益	12,251	12,100	12,750	14,169	+15.7%	+17.1%	+11.1%
率	19.6%	18.5%	18.8%	20.4%	-	-	-
当期純利益 ^{*1}	9,428	8,850	9,400	9,059	△3.9%	+2.4%	△3.6%
率	15.1%	13.6%	13.8%	13.1%	-	-	-
EBITDA ^{*2}	13,783	14,800	15,300	16,189	+17.5%	+9.4%	+5.8%
率	22.1%	22.7%	22.5%	23.3%	-	-	-

先端半導体向けCMP製品およびシリコンウェハ向けポリシング材の販売が好調に推移

- ・売上高：過去最高
- ・営業利益／経常利益：売上増に伴い過去最高（前期比+17.4%／+15.7%）
- ・当期純利益：過年度法人税（12.2億円）および減損損失（3.7億円）を期末に計上したことにより、前期比3.9%減益
- ・為替実績：151円／ドル（25年3月期：152円／ドル）

決算概要 (半期実績)

* 1 純利益：親会社株主に帰属する純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	25年3月期		26年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
売上高	30,746	31,757	33,496	+8.9%	+5.5%	35,908	+13.1%	+7.2%
営業利益	5,702	6,077	6,469	+13.4%	+6.4%	7,357	+21.0%	+13.7%
率	18.5%	19.1%	19.3%	-	-	20.5%	-	-
経常利益	5,620	6,631	6,257	+11.3%	△5.6%	7,912	+19.3%	+26.5%
率	18.3%	20.9%	18.7%	-	-	22.0%	-	-
純利益 ^{*1}	4,370	5,058	4,671	+6.9%	△7.6%	4,387	△13.3%	△6.1%
率	14.2%	15.9%	13.9%	-	-	12.2%	-	-
EBITDA ^{*2}	6,645	7,138	7,533	+13.4%	+5.5%	8,656	+21.3%	+14.9%
率	21.6%	22.5%	22.5%	-	-	24.1%	-	-

先端半導体向けCMP製品が牽引し、上期から下期にかけて需要が加速

<下期>

- ・売上高：半期ベースで過去最高。前年同期比13.1%増収（24年3月期上期から5半期連続で増収）
- ・営業利益：半期ベースで過去2番目（最高益は23年3月期上期）
- ・経常利益：上期は一時的為替差損（台湾ドル独歩高）により営業外損益はマイナス。為替が戻り下期営業外損益はプラス
- ・純利益：下期末の過年度法人税（12.2億円）および減損損失（3.7億円）により、前年同期比13.3%減益

業績予想（通期）

* 1 当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	25年3月期	26年3月期	27年3月期	
	通期実績	通期実績	期初予想	前期比
売上高	62,503	69,404	74,800	+7.8%
営業利益	11,780	13,826	14,500	+4.9%
率	18.8%	19.9%	19.4%	-
経常利益	12,251	14,169	14,500	+2.3%
率	19.6%	20.4%	19.4%	-
当期純利益 ^{*1}	9,428	9,059	10,400	+14.8%
率	15.1%	13.1%	13.9%	-
EBITDA ^{*2}	13,783	16,190	19,200	+18.6%
率	22.1%	23.3%	25.7%	-

想定為替レート：150円/ドル（前年実績：151円/ドル）

- ・売上高：AI関連需要を背景に半導体市場は引き続き堅調に推移し増収
- ・営業利益：CMP製品の需要拡大の追い風あるも、新工場建設等の新規投資に伴う減価償却が始まるため前期比4.9%増益にとどまる
- ・経常利益：営業外損益±0（配当収入等あるも、設備投資のための資金調達関連費用を見込む）
- ・当期純利益：前期末に一過性要因（過年度法人税および減損損失）があり、前期比14.8%増益を見込む
- ・EBITDA：過去最高。EBITDA率は25.7%まで大きく伸長（次々ページご参照）

業績予想（半期）

* 1 純利益：親会社株主に帰属する純利益 * 2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

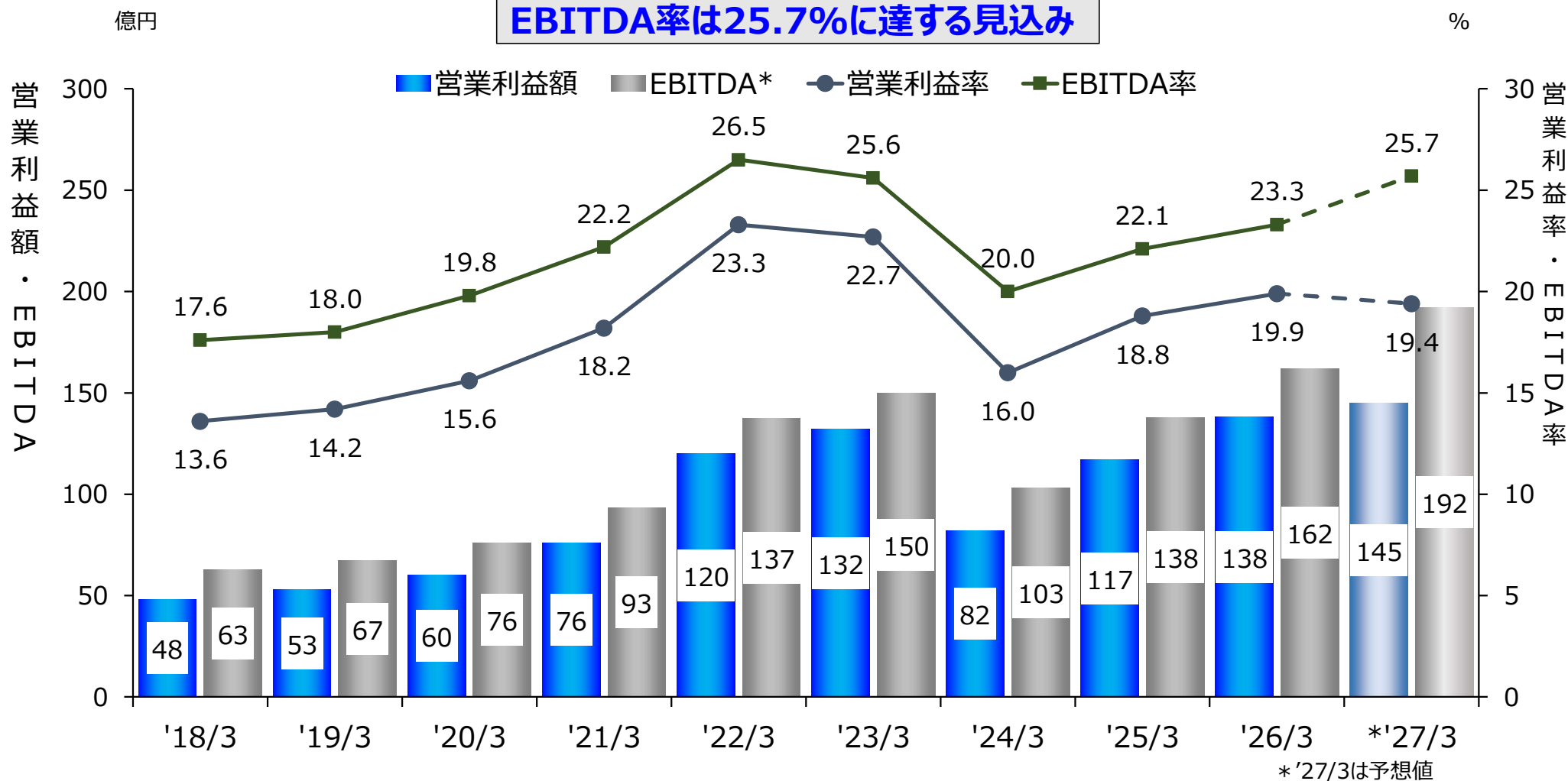
	26年3月期		27年3月期					
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
売上高	33,496	35,908	36,200	+8.1%	+0.8%	38,600	+7.5%	+6.6%
営業利益	6,469	7,357	7,450	+15.1%	+1.3%	7,050	△4.2%	△5.4%
率	19.3%	20.5%	20.6%	-	-	18.3%	-	-
経常利益	6,257	7,912	7,500	+19.9%	△5.2%	7,000	△11.5%	△6.7%
率	18.7%	22.0%	20.7%	-	-	18.1%	-	-
純利益 ^{*1}	4,671	4,387	5,500	+17.7%	+25.3%	4,900	+11.7%	△10.9%
率	13.9%	12.2%	15.2%	-	-	12.7%	-	-
EBITDA ^{*2}	7,533	8,656	8,950	+18.8%	+3.4%	10,250	+18.4%	+14.5%
率	22.5%	24.1%	24.7%	-	-	26.6%	-	-

- ・売上高：AI関連需要を背景に半導体市場は引き続き堅調に推移し、半期ベースでの増収継続
- ・営業利益：CMP製品の需要拡大の追い風あるも、下期から新工場建設等の新規投資に伴う減価償却が始まり、下期は上期比減益
- ・経常利益：上期は資金調達関連費用（金利）を配当収入が上回り営業外損益がプラス
- ・純利益：下期は新工場建設等の新規投資の減価償却費増加により上期比減益となるが、前年下期末の一過性要因（過年度法人税および減損損失）により、前年同期比11.7%増益
- ・EBITDA：下期はEBITDA率は26.6%に達する

営業利益、EBITDA（今期予想含む）

* EBITDA=営業利益+減価償却費

EBITDA率は25.7%に達する見込み



用途別売上高

用途別売上高（通期実績）

単位：百万円

		25年3月期	26年3月期					
		通期実績	期初予想	修正予想 ('25/11)	通期実績	前期比	期初予想比	修正予想比
シリコン	ラッピング	7,563	7,650	7,450	7,590	+0.4%	△0.8%	+1.9%
	ポリシング	12,698	13,250	13,850	13,384	+5.4%	+1.0%	△3.4%
	切断	175	200	100	106	△39.7%	△46.9%	+6.1%
	計	20,437	21,100	21,400	21,081	+3.1%	△0.1%	△1.5%
CMP		30,658	31,600	34,500	36,135	+17.9%	+14.4%	+4.7%
ディスク		2,547	2,550	2,100	2,238	△12.1%	△12.2%	+6.6%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,415	6,600	6,700	6,426	+18.7%	△2.6%	△4.1%
	一般工業用(非研磨材)	3,314	3,350	3,150	3,454	+4.2%	+3.1%	+9.7%
	計	8,729	9,950	9,850	9,880	+13.2%	△0.7%	+0.3%
製品売上高		62,373	65,200	67,850	69,336	+11.2%	+6.3%	+2.2%
商品売上高		129	100	50	68	△47.4%	△31.7%	+36.7%
売上高 合計		62,503	65,300	67,900	69,404	+11.0%	+6.3%	+2.2%

用途別売上高（半期実績）

単位：百万円

		25年3月期		26年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコン	ラッピング	3,791	3,772	3,711	△2.1%	△1.6%	3,878	+2.8%	+4.5%
	ポリシング	6,123	6,574	6,928	+13.1%	+5.4%	6,456	△1.8%	△6.8%
	切断	81	94	52	△35.6%	△44.7%	53	△43.2%	+2.8%
	計	9,996	10,441	10,692	+7.0%	+2.4%	10,389	△0.5%	△2.8%
CMP		15,033	15,625	16,732	+11.3%	+7.1%	19,403	+24.2%	+16.0%
ディスク		1,290	1,256	1,000	△22.5%	△20.4%	1,238	△1.4%	+23.9%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,639	2,775	3,511	+33.1%	+26.5%	2,914	+5.0%	△17.0%
	一般工業用(非研磨材)	1,708	1,605	1,532	△10.3%	△4.6%	1,922	+19.7%	+25.5%
	計	4,348	4,381	5,044	+16.0%	+15.1%	4,836	+10.4%	△4.1%
製品売上高		30,668	31,705	33,468	+9.1%	+5.6%	35,868	+13.1%	+7.2%
商品売上高		78	51	28	△63.8%	△45.6%	40	△22.7%	+42.2%
売上高 合計		30,746	31,757	33,496	+8.9%	+5.5%	35,908	+13.1%	+7.2%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円

		25年3月期	26年3月期	27年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前期比
シリコン	ラッピング	7,563	7,590	7,600	+0.1%
	ポリシング	12,698	13,384	13,500	+0.9%
	切断	175	106	100	△5.8%
	計	20,437	21,081	21,200	+0.6%
CMP		30,658	36,135	41,300	+14.3%
ディスク		2,547	2,238	2,450	+9.4%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,415	6,426	6,200	△3.5%
	一般工業用(非研磨材)	3,314	3,454	3,600	+4.2%
	計	8,729	9,880	9,800	△0.8%
製品売上高		62,373	69,336	74,750	+7.8%
商品売上高		129	68	50	△26.8%
売上高 合計		62,503	69,404	74,800	+7.8%

用途別売上高（半期予想）

単位：百万円

		26年3月期		27年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
シリコン	ラッピング	3,711	3,878	3,750	+1.0%	△3.3%	3,850	△0.7%	+2.7%
	ポリシング	6,928	6,456	6,700	△3.3%	+3.8%	6,800	+5.3%	+1.5%
	切断	52	53	50	△4.5%	△7.1%	50	△7.1%	+0.0%
	計	10,692	10,389	10,500	△1.8%	+1.1%	10,700	+3.0%	+1.9%
CMP		16,732	19,403	19,600	+17.1%	+1.0%	21,700	+11.8%	+10.7%
ディスク		1,000	1,238	1,200	+20.0%	△3.1%	1,250	+0.9%	+4.2%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,511	2,914	3,080	△12.3%	+5.7%	3,120	+7.1%	+1.3%
	一般工業用(非研磨材)	1,532	1,922	1,800	+17.5%	△6.4%	1,800	△6.4%	+0.0%
	計	5,044	4,836	4,880	△3.3%	+0.9%	4,920	+1.7%	+0.8%
製品売上高		33,468	35,868	36,180	+8.1%	+0.9%	38,570	+7.5%	+6.6%
商品売上高		28	40	20	△29.1%	△50.1%	30	△25.2%	+50.0%
売上高 合計		33,496	35,908	36,200	+8.1%	+0.8%	38,600	+7.5%	+6.6%

シリコンウェハー売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

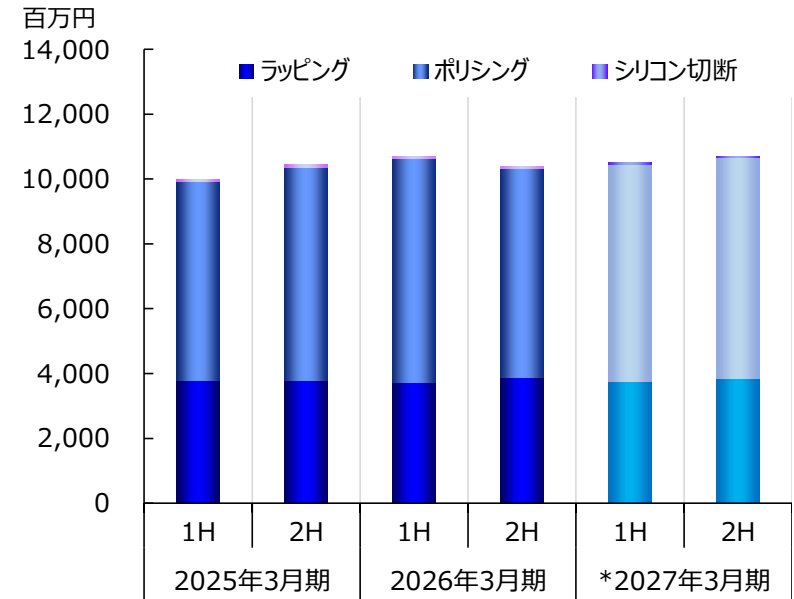
単位：百万円

		25年3月期	26年3月期		27年3月期	
		通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
シリコン	ラッピング	7,563	7,590	+0.4%	7,600	+0.1%
	ポリシング	12,698	13,384	+5.4%	13,500	+0.9%
	切断	175	106	△39.7%	100	△5.8%
	計	20,437	21,081	+3.1%	21,200	+0.6%

《半期》

単位：百万円

		25年3月期		26年3月期		27年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコン	ラッピング	3,791	3,772	3,711	3,878	3,750	3,850
	ポリシング	6,123	6,574	6,928	6,456	6,700	6,800
	切断	81	94	52	53	50	50
	計	9,996	10,441	10,692	10,389	10,500	10,700



(26/3) シリコンウェハー市場は、在庫水準の高止まりや小口径ウェハーの低迷が続いたものの、当社製品はAI向けを中心とした先端需要に支えられ、前期比+3.1%増収

(27/3) 先端ロジック・メモリデバイスメーカーのウェハー需要は継続すると見込まれる一方、ウェハーの市中在庫解消にはなお時間を要するものと想定し、前期並みを予想

CMP売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

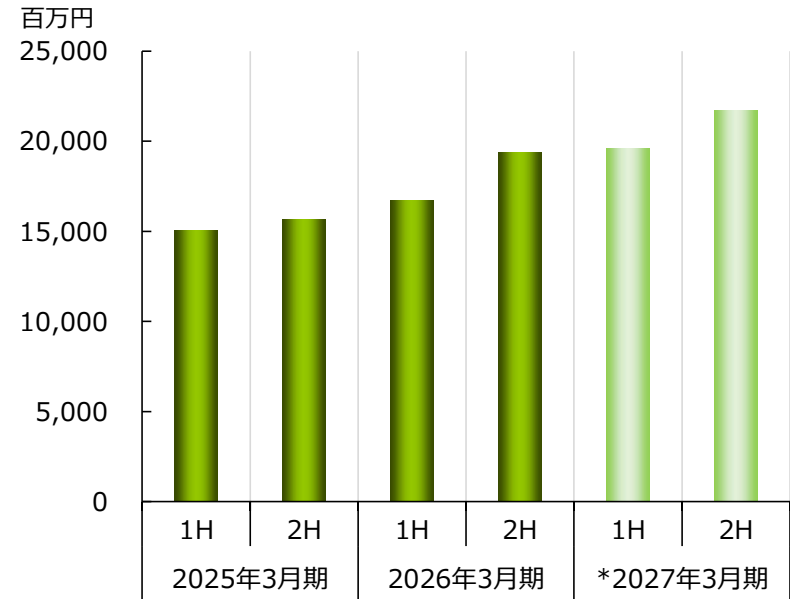
単位：百万円

	25年3月期	26年3月期		27年3月期	
	通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
CMP	30,658	36,135	+17.9%	41,300	+14.3%

「半期」

単位：百万円

	25年3月期		26年3月期		27年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	15,033	15,625	16,732	19,403	19,600	21,700



- (26/3) ・旺盛なAI関連需要を背景に、先端ロジックおよびメモリ向けを中心として増収
・下期にかけて顧客の在庫積み上げもあり、需要は一段と高まった
- (27/3) ・AI関連を中心とした先端半導体需要およびデータセンター投資の継続を背景に、半導体市場は引き続き堅調に推移すると想定し、14.3%の増収を見込む
・後工程CMPでの採用開始を見込む

ディスク売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

単位：百万円

	25年3月期	26年3月期		27年3月期	
	通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
ディスク	2,547	2,238	△12.1%	2,450	+9.4%

「半期」

単位：百万円

	25年3月期		26年3月期		27年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	1,290	1,256	1,000	1,238	1,200	1,250

百万円

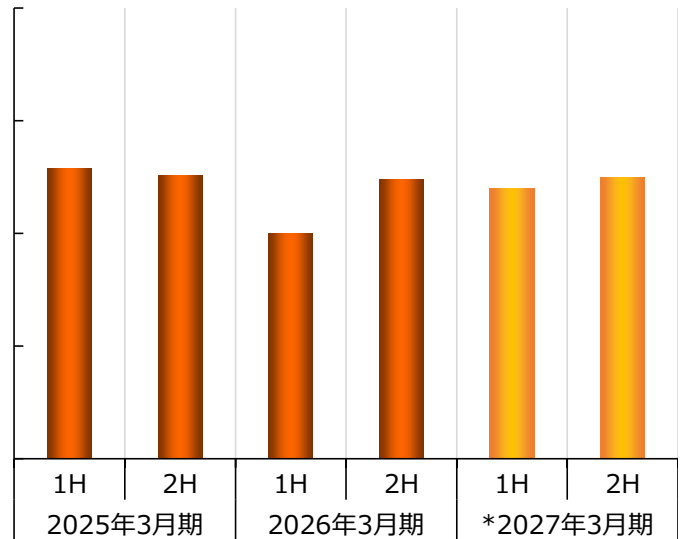
2,000

1,500

1,000

500

0



*'27/3は予想値

(26/3) データセンター向けHDDの旺盛な需要を背景に顧客の稼働は高水準で推移したものの、顧客の生産プロセス改善の影響により減収

(27/3) HDD需要は引き続き高水準で推移すると想定

機能材・溶射材売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

単位：百万円

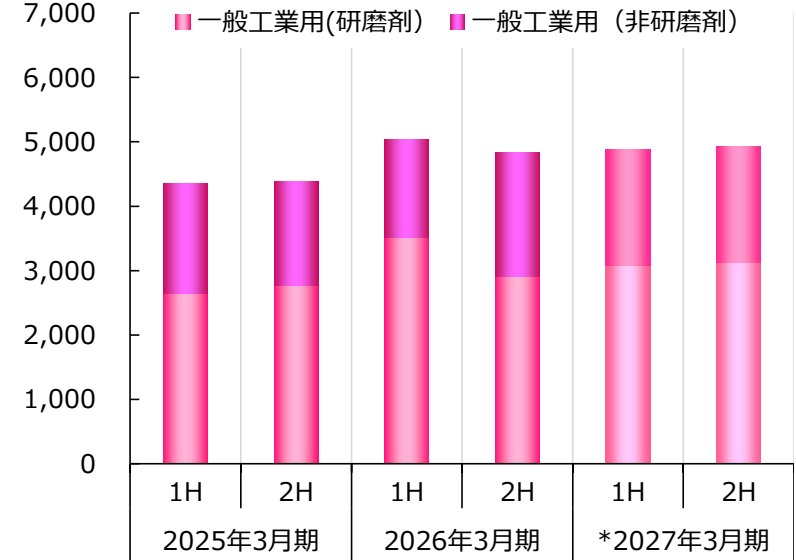
		25年3月期	26年3月期		27年3月期	
		通期実績	通期実績	前期比	通期予想	前期比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,415	6,426	+18.7%	6,200	△3.5%
	一般工業用(非研磨材)	3,314	3,454	+4.2%	3,600	+4.2%
	計	8,729	9,880	+13.2%	9,800	△0.8%

「半期」

単位：百万円

		25年3月期		26年3月期		27年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,639	2,775	3,511	2,914	3,080	3,120
	一般工業用(非研磨材)	1,708	1,605	1,532	1,922	1,800	1,800
	計	4,348	4,381	5,044	4,836	4,880	4,920

百万円



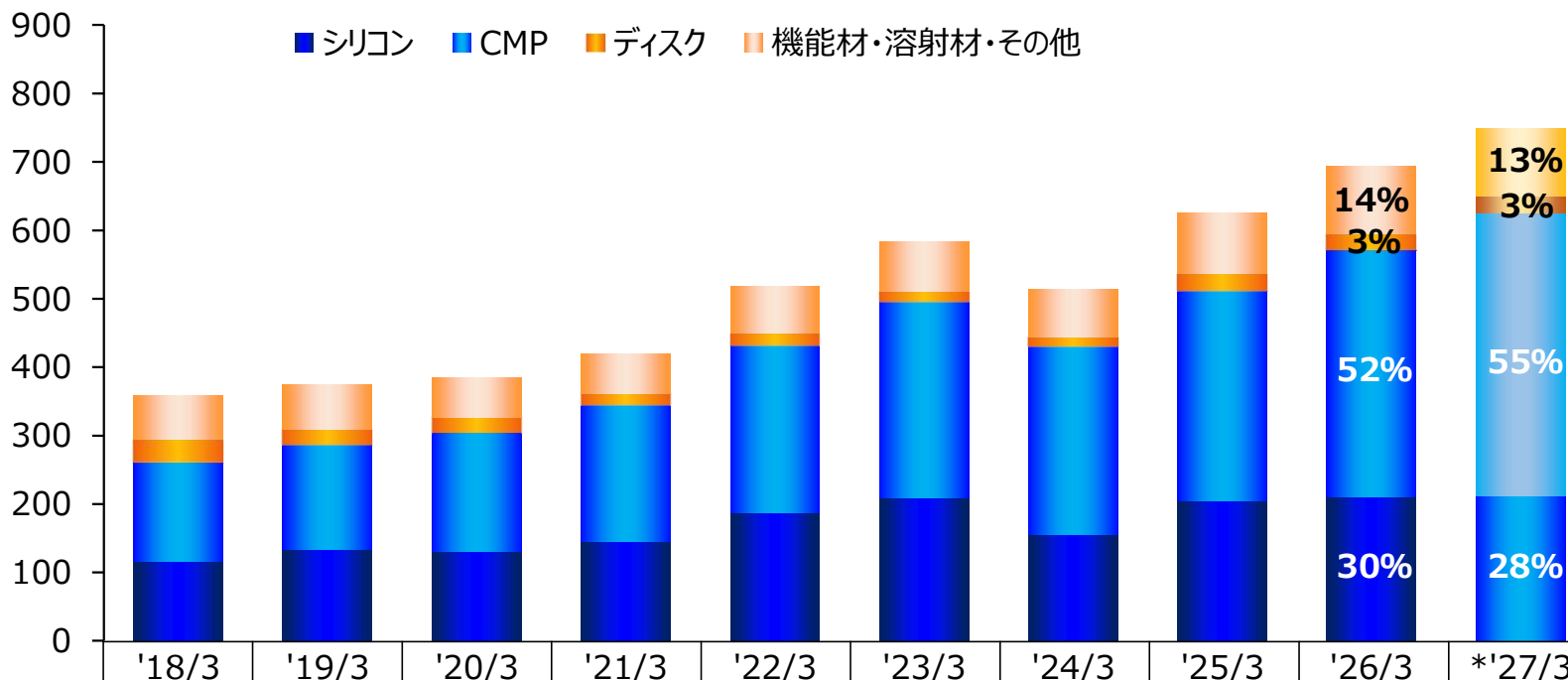
【研磨材】(26/3) 南興セラミックスの子会社化に伴い増収
(27/3) 前期並みを予想 (26/3上期に装置関連のスポット受注あり)

【〃以外】(26/3) FPD製造装置向け溶射材を中心に増収
(27/3) 半導体製造装置および産業機械向け溶射材の需要増を見込み、増収予想

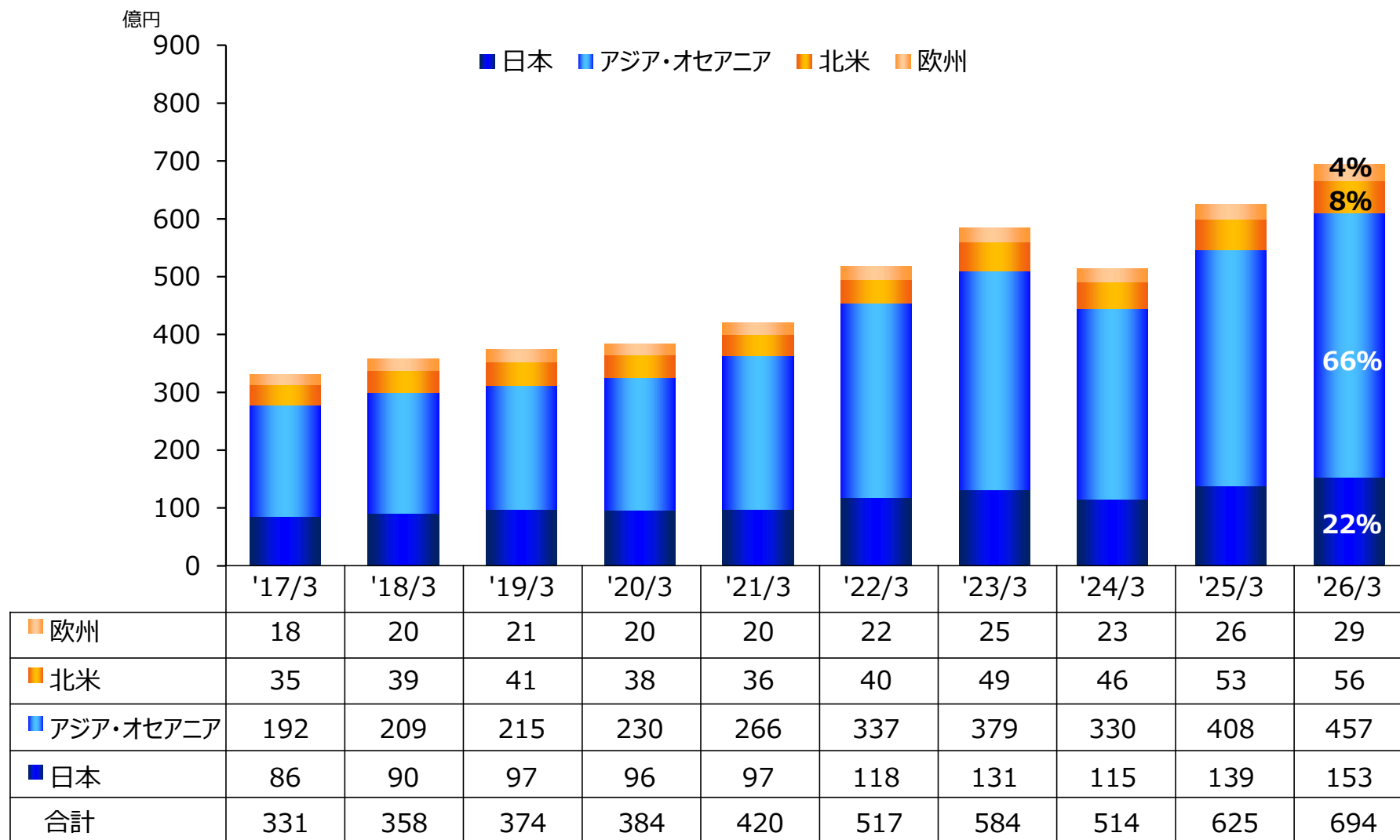
* '27/3は予想値

用途別売上高（通期）

億円



地域別売上高（通期 仕向先別）



設備投資額 減価償却費 研究開発費

中期的な設備投資計画

2022年6月 2022年3月期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

各務山新工場建設（計画）

敷地面積：28千㎡

’21年12月に売買契約を締結

- シリコン、CMP製品の生産能力増強

FUJIMI CORPORATION（米国）

既存工場敷地内に新棟建設を計画

- CMP生産スペース拡大

FUJIMI TAIWAN（台湾）

- 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター（仮称）建設（計画）

敷地面積：16千㎡

現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済

- 非半導体関連の研究施設を設置



中期的な設備投資計画（アップデート）

2025年5月 2025年3月期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
<p>各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ '21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強</p>	<p>'24年10月 着工 '25年末 竣工 '26年中 試作品出荷 '27年中 本格生産開始</p>	<p>【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済</p>
<p>FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品</p>	<p>新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） '25年末 設備設置完了</p>	<p>2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設</p>
<p>FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、 順次CMP生産設備の導入を計画</p>	<p>'25年末 導入完了 '26年 生産開始</p>	<p>2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を開始</p>

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

<p>第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置</p>	<p>'25年5月 着工 '26年10月 竣工</p> <p>完成予想図→</p>	
--	---	--

中期的な設備投資計画（アップデート）

2025年11月 2025年3月期第2四半期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ '21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	'24年10月 着工 '25年末 竣工 '26年中 試作品出荷 '27年中 本格生産開始	【Phase2】 顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】 2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品は市場動向を鑑み見送り	新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） '25年末 設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、 順次CMP生産設備の導入を計画	'25年末 導入完了 '26年 生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を開始

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置	'25年5月 着工 '26年10月 竣工 完成予想図→	
---	-----------------------------------	--

中期的な設備投資計画（アップデート）

青色：完了 赤色：変更

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ '21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	'24年10月 着工 '26年2月 竣工 '26年中 試作品出荷 '27年中 本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品は市場動向を鑑み見送り	新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） '27年4月 増産開始	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、 順次CMP生産設備の導入を計画	'25年末 導入完了 '26年6月 増産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地を選定中

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置	'25年5月 着工 '26年10月 竣工 完成予想図→	
--	-----------------------------------	--

中期的な設備投資計画（各務山新工場アップデート）

各務山新工場 2026年2月竣工

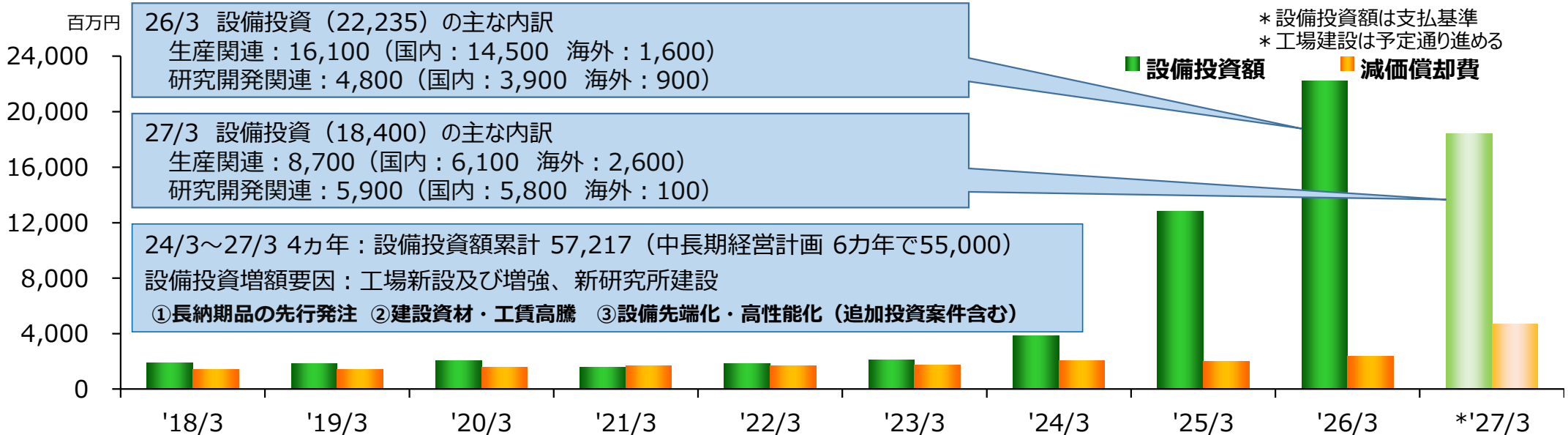


青枠：各務山新工場
赤枠：将来の拡張に向けた取得済み工場用地

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

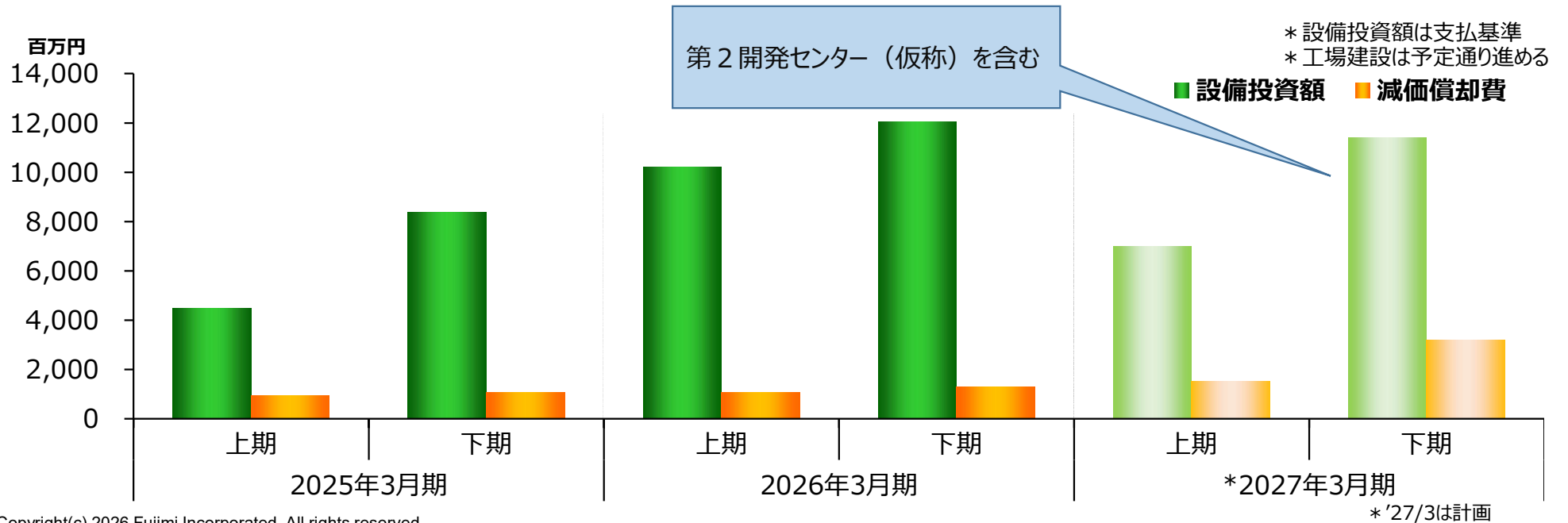
	25年3月期	26年3月期			27年3月期				
	通期実績	期初予想	修正計画	通期実績	前期比	期初予想比	修正計画比	期初計画	前期比
設備投資額	12,844	29,600	27,600	22,235	+73.1%	△24.9%	△19.4%	18,400	△17.2%
減価償却費	2,003	2,700	2,300	2,363	+18.0%	△12.5%	+2.7%	4,700	+98.9%



設備投資額・減価償却費（半期実績・半期計画）

単位：百万円

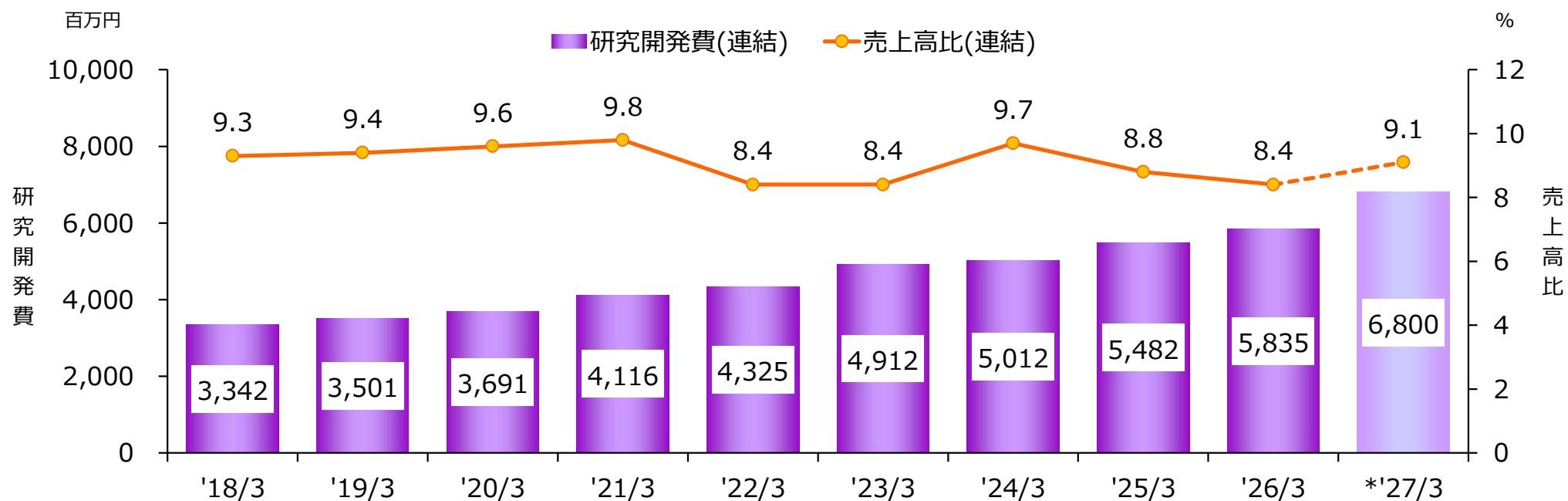
	25年3月期		26年3月期				27年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	前年同期比	同年上期比	上期計画	前年同期比	前年下期比	下期計画	前年同期比	同年上期比
設備投資額	4,473	8,371	10,201	12,034	+43.8%	+18.0%	7,000	△31.4%	△41.8%	11,400	△5.3%	+62.9%
減価償却費	942	1,060	1,064	1,299	+22.5%	+22.1%	1,500	+41.0%	+15.5%	3,200	+146.3%	+113.3%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	25年3月期	26年3月期					27年3月期		
	通期実績	期初予想	修正予想 ('25/11)	通期実績	前期比	期初予想比	修正予想比	期初計画	前期比
研究開発費	5,482	5,700	5,800	5,835	+6.5%	+2.4%	+0.6%	6,800	+16.5%



損益分析

営業利益増減要因（73期実績→74期実績）

売上高 625億円

25/3期
実績

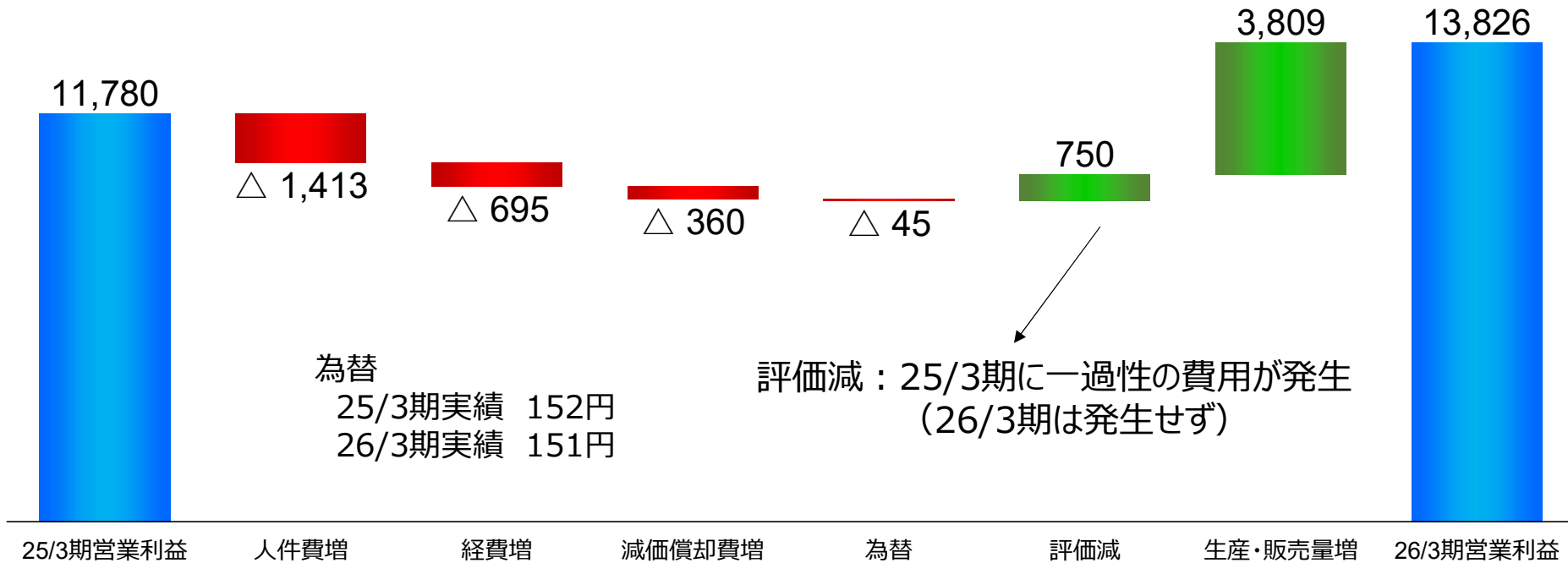
(売上増)
(利益増)
※EBITDA

+6,902百万円
+2,046百万円
+2,406百万円

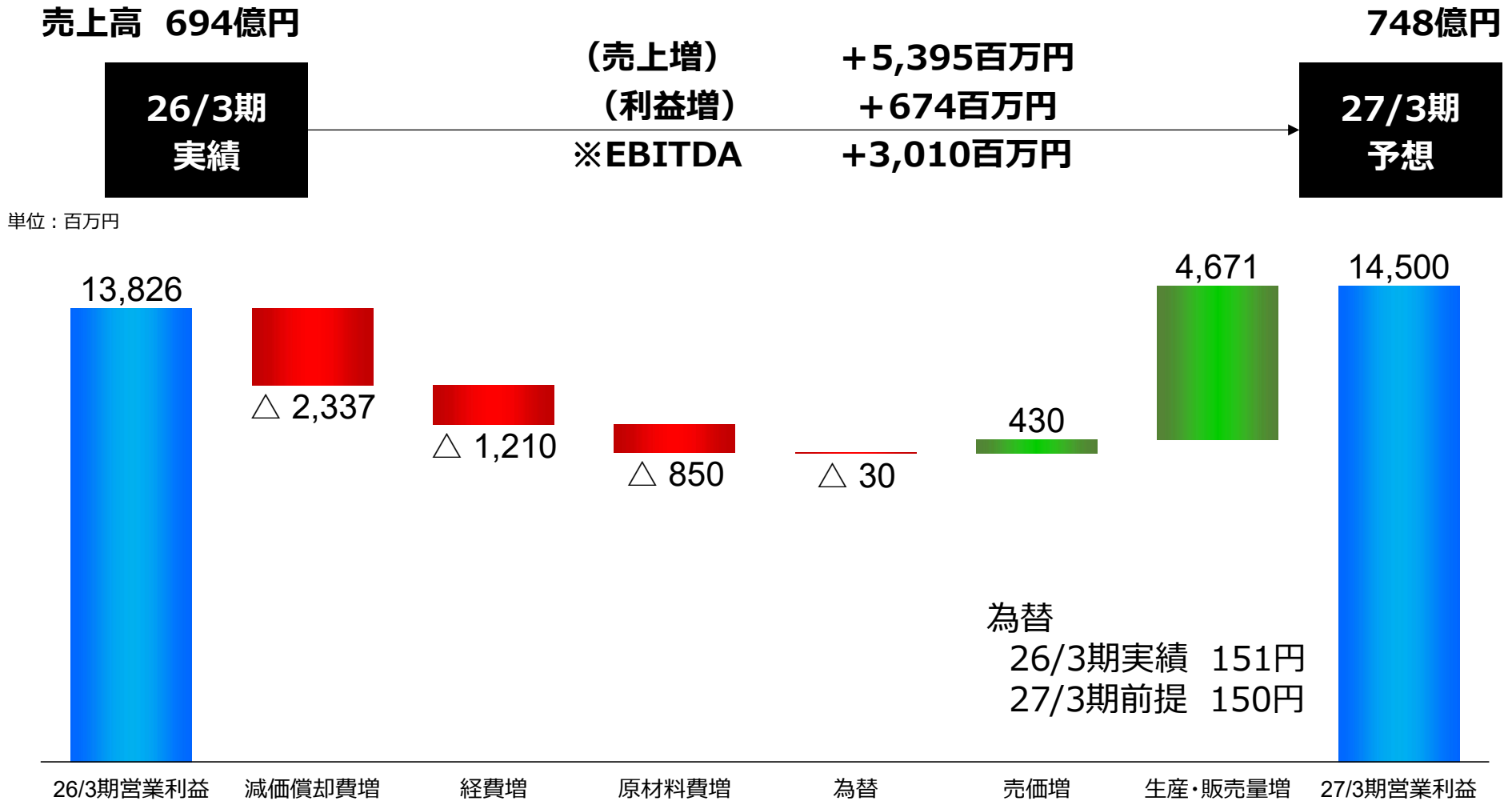
694億円

26/3期
実績

単位：百万円



営業利益増減要因 (74期実績→75期業績予想)



株主還元

配当政策の変更

配当政策	具体的な指標等	
	～2026年3月期	2027年3月期～
1. 業績に応じた積極的な株主還元	連結配当性向 55%以上	連結配当性向 55%以上
2. 安定配当の継続	-	<u>“配当維持または増配を行う累進配当”を導入</u> (2027年3月期～2029年3月期)

変更理由： 成長投資と株主還元の両立を意識した上で、事業環境の変化に左右されない、より強固な安定還元の実現を図ることで、企業価値を持続的に高めるため。

積極的な株主還元と安定配当の継続

■ 新配当政策

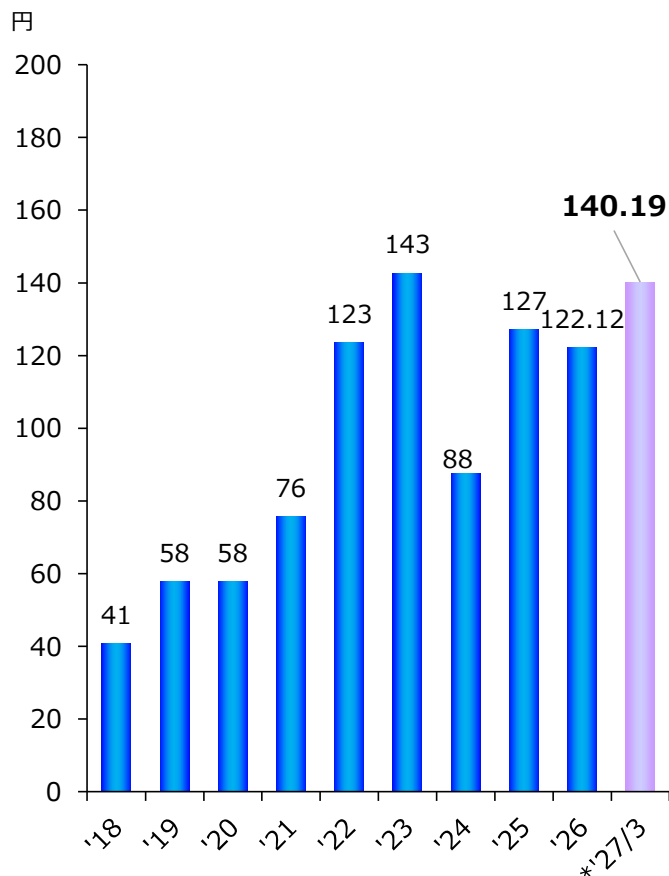
1. 業績に応じた積極的な株主還元：連結配当性向 55%以上
2. 安定配当の継続：**累進配当（2027年3月期～2029年3月期）**

■ 1株当たり配当金

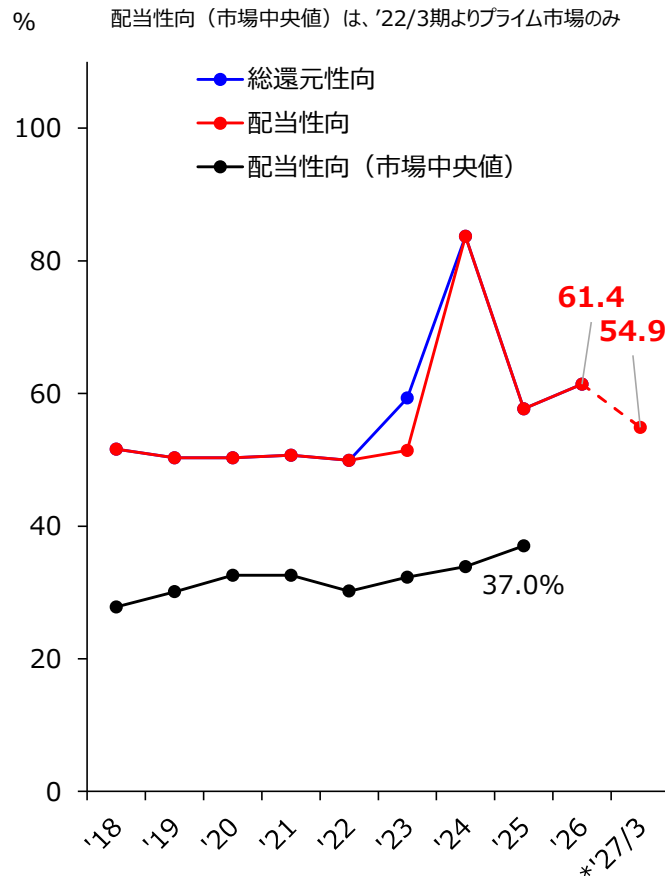
	2025/3月期		2026/3月期		2027/3月期
	期初予想 2024/5/13	実績 2025/5/13	期初予想 2025/5/13	実績 2026/5/14	期初予想 2026/5/14
中間配当金	36.67円	36.67円	36.67円	36.67円	38.50円
期末配当金	36.67円	36.67円	36.67円	38.33円	38.50円
年間配当金	73.34円	73.34円	73.34円	75.00円	77.00円
配当性向	57.7%		61.4%		54.9%

積極的な株主還元と安定配当の継続

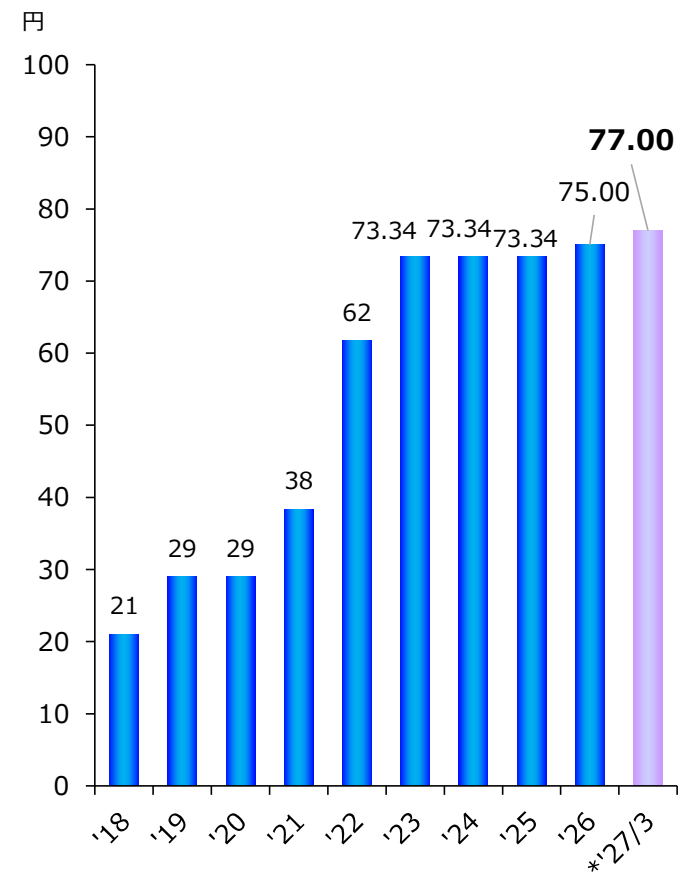
1株当たり当期純利益



総還元性向・配当性向



1株当たり配当金



*'27/3は計画

中長期経営計画

中長期経営計画 進捗

- 中長期経営計画比

74期【売上高】**-76億円 -10%** CMP・一般工業用（非研磨材）は売上高達成なるもシリコンウェハー向け及びM&A関連が未達

75期【売上高】**-87億円 -10%** 同上

単位：億円（億円未満切捨て）

目標項目	72期 2024年3月期		73期 2025年3月期		74期 2026年3月期		75期 2027年3月期	
	中計	実績	中計	実績	中計	実績	中計	期初予想
売上高	585	514	702	625	770	694	835	748
非半導体売上高	15.0%	14.9%	18.1%	17.1%	20.0%	16.6%	19.9%	16.1%
EBITDAマージン*1	25.0%	20.0%	25.9%	22.1%	26.0%	23.3%	26.4%	25.7%
ROE*2	13.9%	9.2%	15.0%	12.7%	15.0%	11.3%	15.0%	12.1%

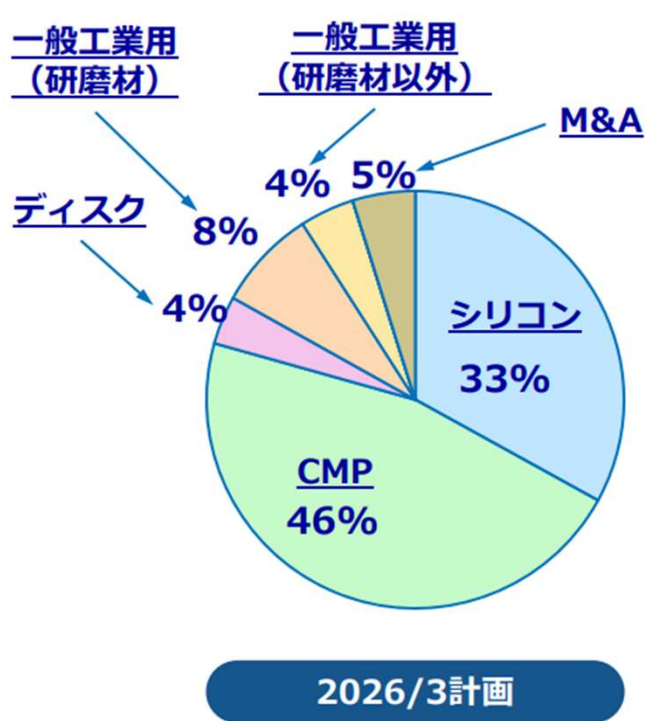
*1 EBITDAマージン = (営業利益 + 減価償却費) ÷ 売上高 × 100

*2 ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100

青字は達成 赤字は未達成

中長期経営計画 2026年3月期 予実対比

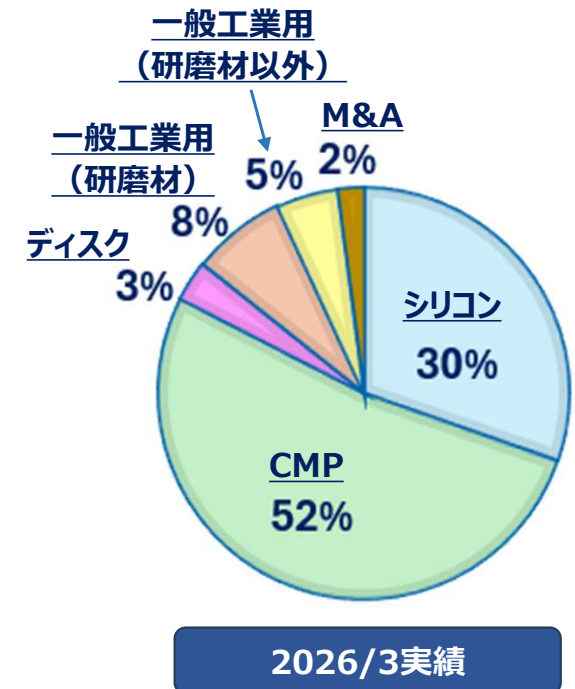
- 達成：CMP、一般工業用（非研磨材）
- 未達成：シリコン、ディスク、一般工業用（研磨材）、M&A
- 最先端半導体向けで売上高を拡大しているCMPの構成比が計画以上に大きくなっている



単位：億円（億円未満切捨て）

	74期 2026年3月期		
	中計	実績	差異
CMP	354	361	+7
シリコン	254	210	-44
ディスク	31	22	-9
一般工業用(研磨材)	62	51	-11
一般工業用(非研磨材)	31	34	+3
M&A	39	14	-25
合計	770	694	-76

青字は達成 赤字は未達成



2026年3月期 業績サマリー／2027年3月期 業績予想

*1 当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益 *2 EBITDA=営業利益+減価償却費

【2026年3月期 業績サマリー】

✓ 売上高	+11.0%	： 先端半導体向けCMP製品およびシリコンウェハー向けポリシング材の販売が好調に推移し、過去最高
✓ 営業利益	+17.4%	： 売上増に伴い過去最高
✓ 経常利益	+15.7%	： 売上増に伴い過去最高
✓ 当期純利益*1	△3.9%	： 過年度法人税および減損損失を期末に計上したことにより減益
✓ シリコンウェハー向け	+3.1%	： 市場の回復にはばらつきが見られたものの、AI関連を中心とした先端需要を背景に増収
✓ CMP向け	+17.9%	： 先端ロジックデバイスおよびメモリ向け製品の販売増により増収
✓ ハードディスク向け	△12.1%	： HDD需要は旺盛であったものの、顧客の生産プロセス改善の影響により減収
✓ 一般工業用向け	+13.2%	： 子会社化した南興セラミックスの売上高取り込み、溶射材の販売増等により増収
✓ 株主還元		： 増配、配当性向 61.4%

【2027年3月期 業績予想】

✓ 売上高	+7.8%	： AI関連需要を背景に半導体市場は引き続き堅調に推移するものと想定
✓ 営業利益	+4.9%	： CMP製品の需要拡大の追い風あるも、新工場等の減価償却が始まり、微増益に留まる
✓ 経常利益	+2.3%	： 配当収入等あるも、設備投資のための資金調達関連費用を見込む
✓ 当期純利益*1	+14.8%	： 前期末に一過性要因（過年度法人税および減損損失）あり
✓ EBITDA*2	+18.6%	： 過去最高を見込む

The logo consists of the word "FUJIMI" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are stylized, with the 'F' having a thick vertical stem and a horizontal top bar. The 'U' is a simple, rounded shape. The 'J' has a thick stem and a curved bottom. The 'I' is a simple vertical bar. The 'M' is a simple, rounded shape. The 'I' at the end is a simple vertical bar.

FUJIMI INCORPORATED